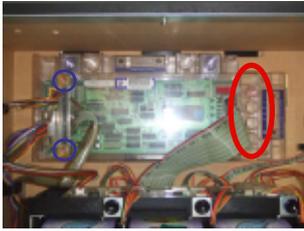


# 脱着手順

## 1, メイン基盤及びロム基盤脱着手順 (サミー・ロデオ系)



(a) ケース右側のラベル (赤印) がある場合は、カッター等でラベルに切り目を入れて下さい。ケース左側の2カ所 (青丸) のネジを外し、コネクタカバーを取り外します。



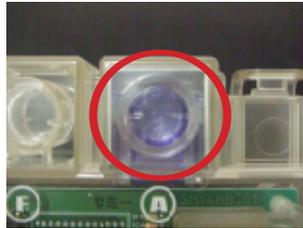
(b) 全てのコネクタを外します。



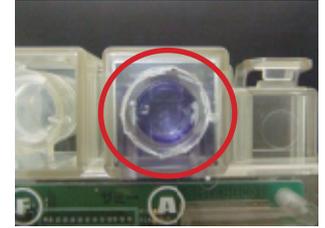
(c) ニッパ等の工具で、ケース本体と固定部分を切り離します。



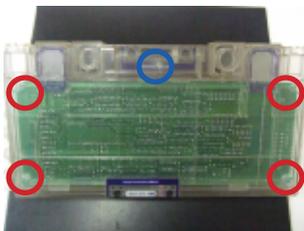
(d) 固定部分を切り離したら、ピンマーク部分を押上げてメイン基板ケースを手前に引いて取り外します。



(e) 取り外したケースを開けるには、左右対称2ヶ所に有る固定部分を取り外す必要があります。



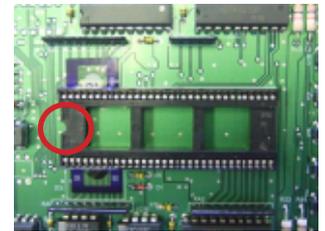
(f) お手持ち等の工具を利用して、固定部分と分離しケースカバーを開ける状態にします。



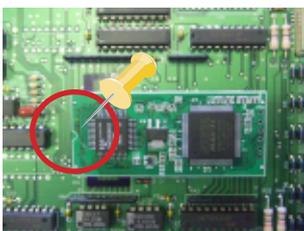
(g) メイン基板裏側のネジ (青丸) を外しケースを開け、基板部分4ヶ所のネジ (赤丸) を外します。



(h) 一連の作業が終わると、写真の様にケースと基板を取り外す事が出来ます。CPUロムは、IC専用治具等で外します。取付けソケットを痛め無い様に気を付けて下さい。



(i) CPUロムを外した状態です。ソケット部分にくぼみがある方向を確かめます (赤丸)。この場合は左側になります。



(j) CPUロム基板とメイン基板のくぼみの位置が正しいか確認して下さい。また、ピン位置がずれてないか確認した上で取付作業を行って下さい。(ピンは折れ易いので気を付けて下さい)

a ~ j までの作業が終わりましたら、行ってきた作業と反対の手順で再組み立てを行って下さい。

作業を始める際には、必ず主要電源を切ってから行って下さい。故障等の原因になります。

取り外しの際に、ステンレス製止め金具が2個出てきますが不要でしたら破棄されて構いません。

ご不明な点が御座いましたら、お問い合わせ下さい。